

株式会社エンプラス

2007年3月期

第3四半期決算説明会

2007年 1月26日

取締役 IR室長

酒井 崇

2007年3月期 経営基本方針

創45 New Enplas の力強い発信を目指し

- 改革から成長へのゆるぎない
健全経営軌道の構築
- 発明力・量産供給力を高め、
業界先行力の飛躍的向上
- アジア地域を最重点とした
グローバル事業の再編・最適化
- 新事業創出の加速

第3四半期（9ヶ月）実績比較

（単位：億円）

2006年3月期
第3四半期
(9ヶ月)実績

2007年3月期
第3四半期
(9ヶ月)実績

売上高

(原価率)

312.3

(70.0%)

23.0%
→

240.5

(68.6%)

営業利益

33.2

43.9%
→

18.6

経常利益

34.3

43.3%
→

19.5

当期純利益

15.5

81.5%
→

2.8

1株当たり当期純利益

75.01_円

60.87_円
→

14.14_円

第3四半期（3ヶ月）実績比較 （単位：億円）

	2006年3月期		2007年3月期		第3四半期
	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	
<u>売上高</u>	108.6	89.5	86.0	77.3	77.1
<u>（原価率）</u>	(69.3%)	(73.7%)	(69.1%)	(69.5%)	(67.1%)
<u>営業利益</u>	12.8	3.6	6.6	4.8	7.1
<u>経常利益</u>	13.1	3.9	6.6	5.3	7.5
<u>当期純利益</u>	7.8	0.4	2.6	4.1	4.2
<u>1株当たり当期純利益</u>	38.03 円	2.27 円	13.08 円	20.17 円	21.41 円

セグメント別売上（9ヶ月）実績比較

（単位：億円）

2006年3月期
第3四半期
(9ヶ月)実績

2007年3月期
第3四半期
(9ヶ月)実績

エンプラ事業	117.8	3.0% →	114.3
半導体機器事業	42.8	16.9% →	50.1
液晶関連事業	70.8	52.9% →	33.4
オプト事業	80.7	47.1% →	42.6
計	312.3	23.0% →	240.5

セグメント別売上（3ヶ月）実績比較

（単位：億円）

	2006年3月期		2007年3月期		第3四半期
	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	
エンプラ事業	38.1	36.8	37.5	38.0	38.7
半導体機器事業	15.6	15.5	16.1	15.2	18.7
液晶関連事業	27.2	19.5	15.2	9.5	8.6
オプト事業	27.4	17.6	17.0	14.5	11.1
計	108.6	89.5	86.0	77.3	77.1

2007年3月期 第3四半期(3ヶ月) 決算概要

➤ 売上高横這い 77.2 億円 (2Q比: 1.8 百万円)

◆ 液晶関連・オプト事業の減収を半導体機器事業がカバー

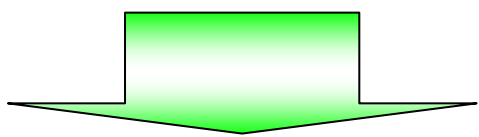
➤ 売上総利益 32.9% 過去最高(2005年3月期 31.3%)水準

◆ 半導体機器事業の構成比拡大 (4.6 ポイント)

◆ 液晶関連事業の構成比減少 (1.2 ポイント)

➤ 単体の固定費 1,889 百万円

(2Q比: 157 百万円 前年同期比: 827 百万円)



売上高営業利益率	9.2%
売上高経常利益率	9.8%

➤ 構造改革完了に伴う特別損益の改善(2Q比: 1,133 百万円)

2007年3月期 通期修正計画

(単位：億円)

	通期計画 (中間決算時)	通期 修正計画	2007年3月期 第3四半期 (9ヶ月)実績
<u>売上高</u> (原価率)	320.0 (69.7%)	320.0 (69.4%)	240.5 (68.6%)
<u>営業利益</u>	20.0	23.0	18.6
<u>経常利益</u>	20.0	24.0	19.5
<u>当期純利益</u>	3.0	3.0	2.8
<u>1株当たり当期純利益</u>	14.79円	15.14円	14.14円
<u>1株当たり配当</u>	20.00円	20.00円	- 円

セグメント別売上通期修正計画

(単位：億円)

	通期計画 (中間決算時)	通期 修正計画	2007年3月期 第3四半期 (9ヶ月)実績
エンプラ事業	150.0	154.0	114.3
半導体機器事業	70.0	74.0	50.1
液晶関連事業	45.0	42.0	33.4
オプト事業	55.0	50.0	42.6
計	320.0	320.0	240.5

参考指標

(單位：億円)

	通期計画 (中間決算時)	通期 修正計画	2007年3月期 第3四半期 (9ヶ月)実績
<u>設備投資額</u>	16.0	18.0	13.4
<u>減価償却費</u>	26.0	27.0	20.8
<u>試験研究費</u> (売上高比)	15.0 (4.7%)	12.5 (3.9%)	9.4 (3.9%)

各事業セグメントの ビジネス動向

エンプラス事業の動向

前期	⋮	今期			(億円)
第4四半期	⋮	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期 計画
36	⋮	37	38	38	39
3Qハイライト			4Qの戦略		

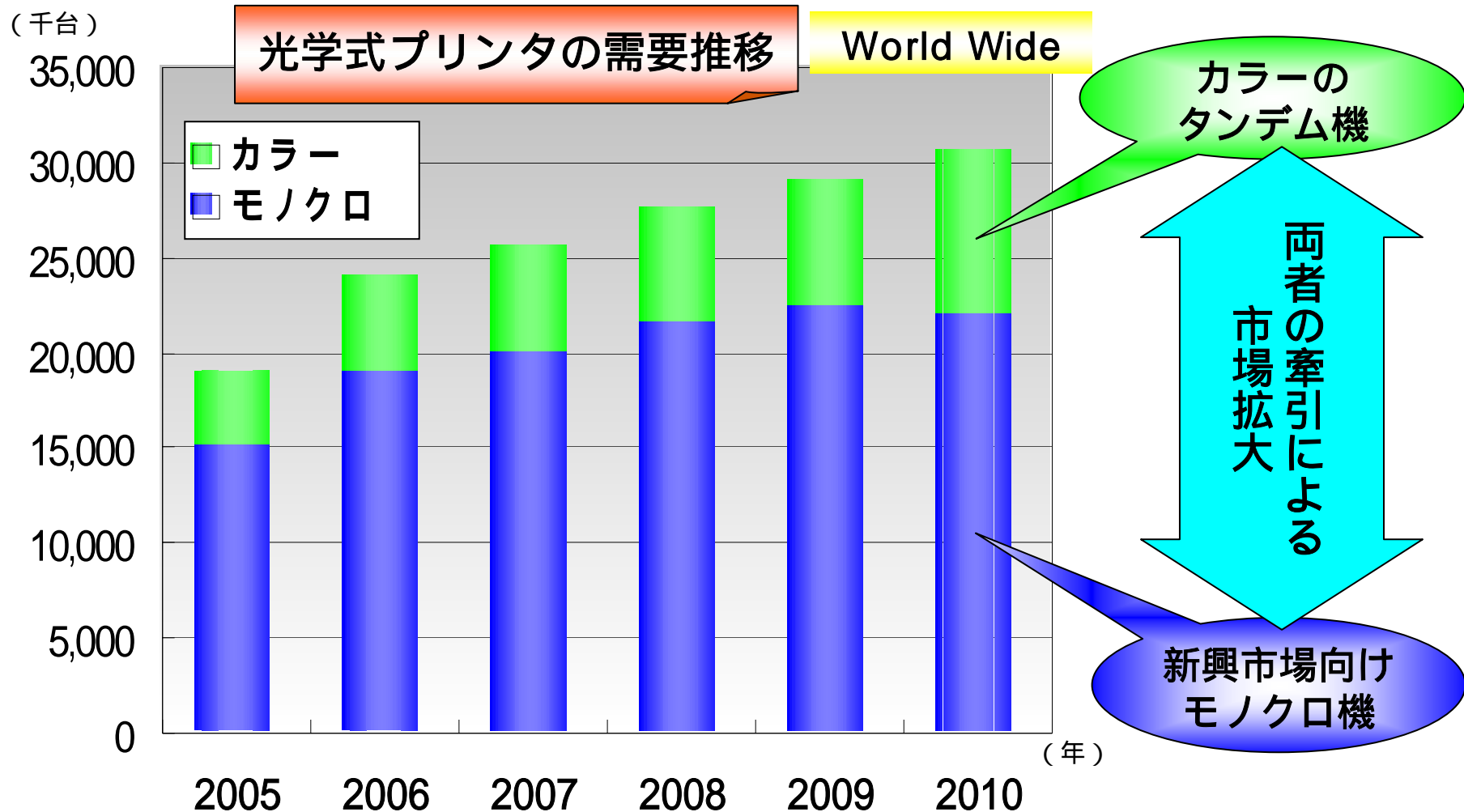
- 広州（中国）に子会社設立
Guangzhou Enplas Mechatronics Co.,Ltd.
 - ◆ エンプラス・液晶関連ビジネスを主体とした中国華南地域での事業基盤構築
- ギヤマーケットの領域拡大
 - ◆ エンプラス開発ギヤの上市
- 精密機構部品の新規製品開発と積極的な受注獲得

- 好調なO A 機器市場への対応
- エンプラス開発ギヤの拡販
 - ◆ 低騒音/高強度/高機能ギヤ
- 海外市場展開の加速
 - ◆ グローバル連携強化
 - ◆ 金型製作のコア事業化
- 精密機構部品の拡販



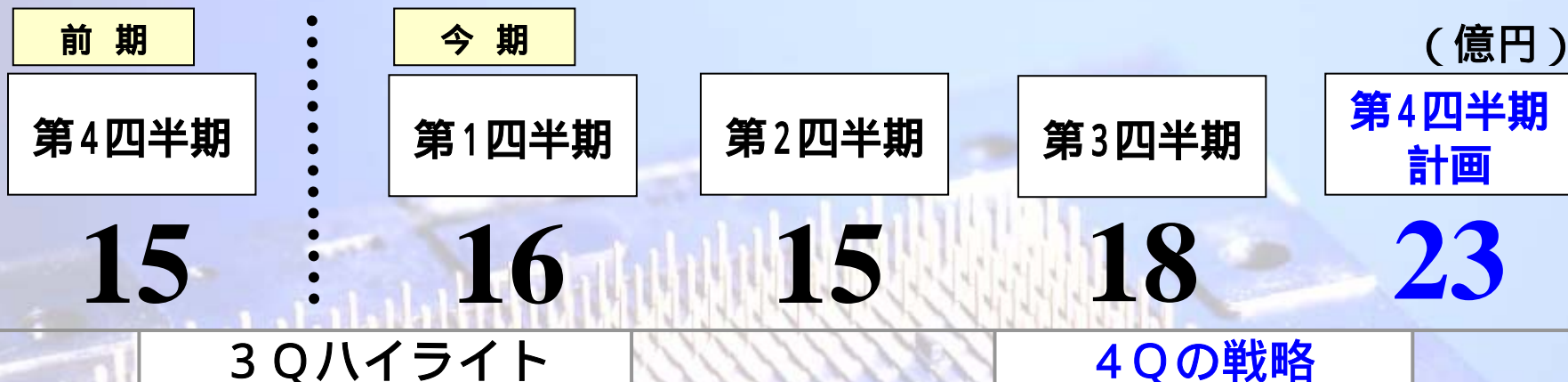
エンプラ事業の動向

➤ O A 市場環境予測



(当社予測)

半導体機器事業の動向



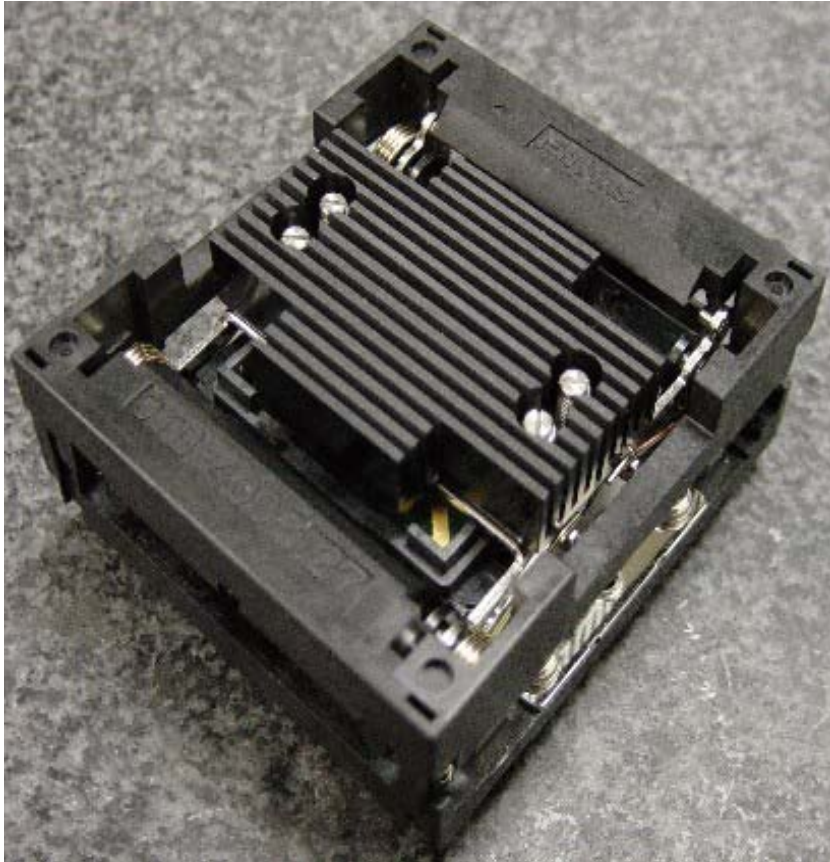
➤プローブカード事業のビジネス基盤強化と収益性向上

- テストソケット事業の市場シェア拡大
 - ◆主要顧客との開発促進
 - ◆現場主義の実践 生産性の追求
- ハイパワーバーンインシステム用ソケットの拡販
- プローブカードの収益基盤確立
- 韓国市場の開拓
- 新規ビジネスの開発
- LCDドライバー用プローブカード開発



半導体機器事業の動向

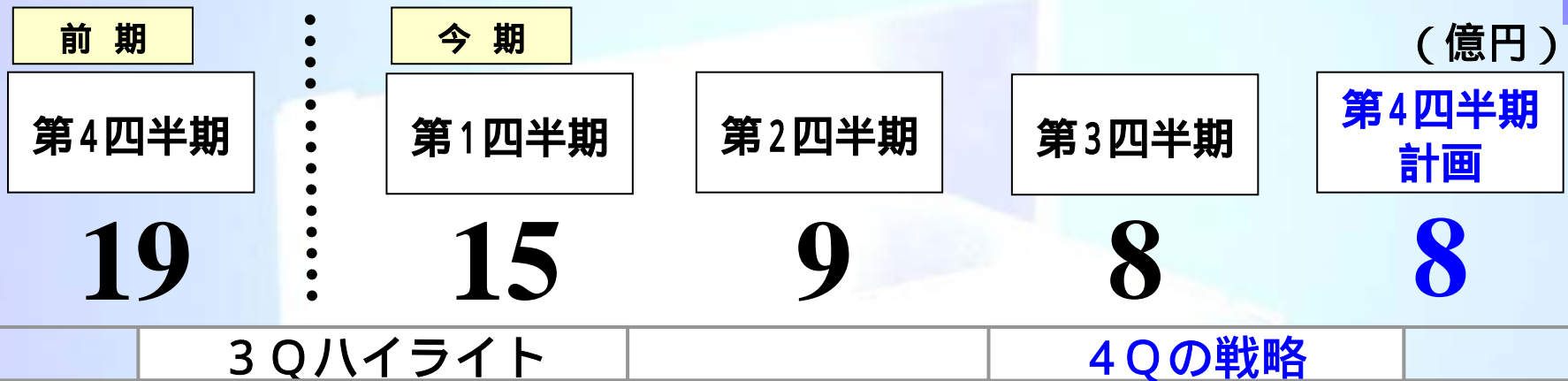
▶ ハイパワーバーンインソケット



最先端CPU・画像処理ICの高速処理
(サーバー・PC・車・ゲーム機など)

- ・ 150 ~ 400Wの大消費電力
- ・ 高発熱
- ・ 2,000 ~ 4,000ピンの多数ピン

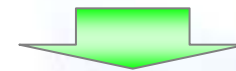
液晶関連事業の動向



次世代ノートPC用導光板の開発及び上市

- ▶ ノートPC用導光板の拡販
 - ◆ 日本と韓国 台湾メーカーへ
 - ◆ 中高位機種に的を絞る
- ▶ 小型用LGPの中国戦略強化
(現地生産を視野に)
- ▶ 次世代LGPの開発促進

- ▶ WPS-LGP(両面プリズム導光板)の完成 量産体制の確立



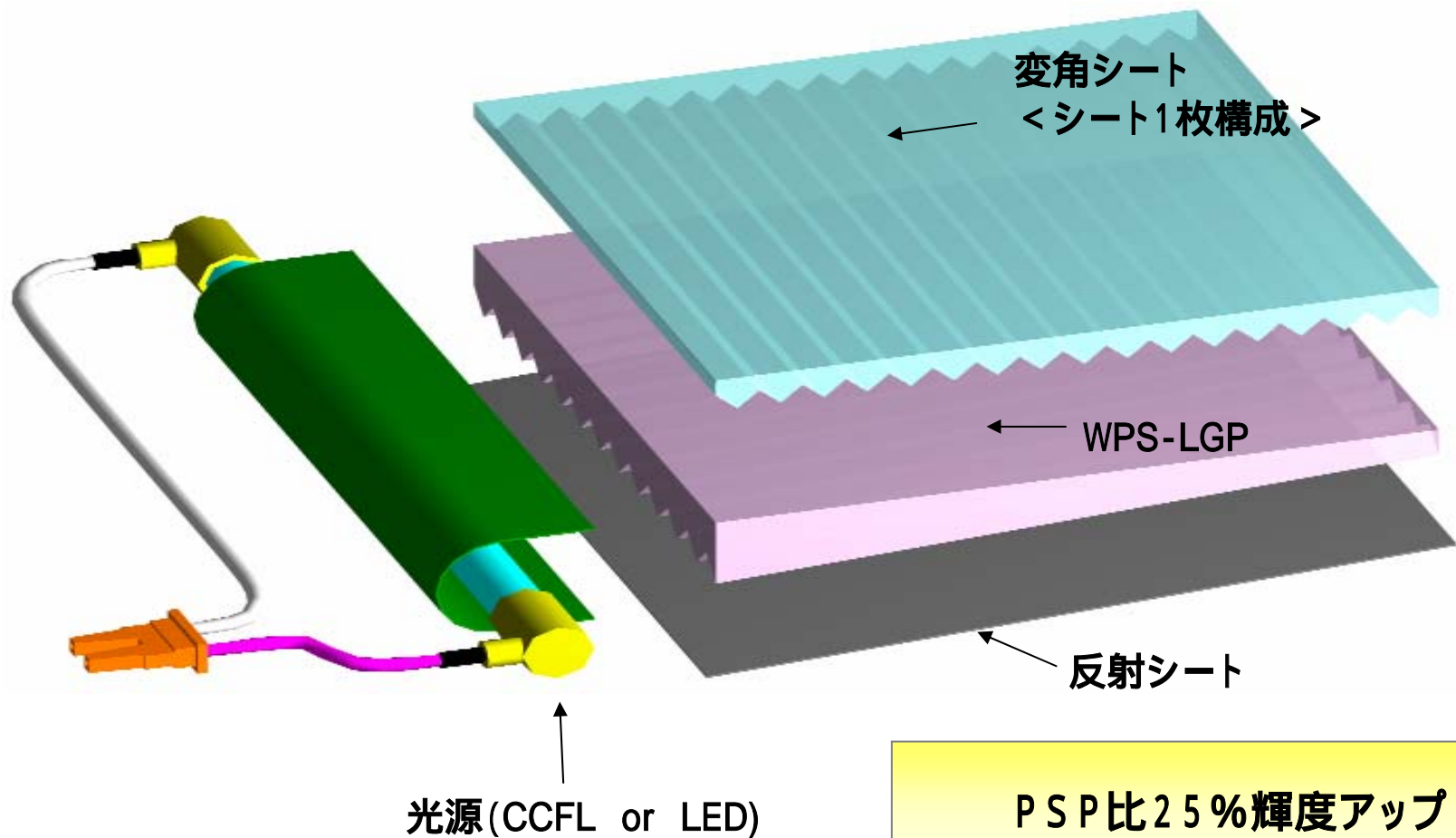
拡販



- ▶ 小型用LGPの拡販
- ▶ 本格的な中国市場への進出

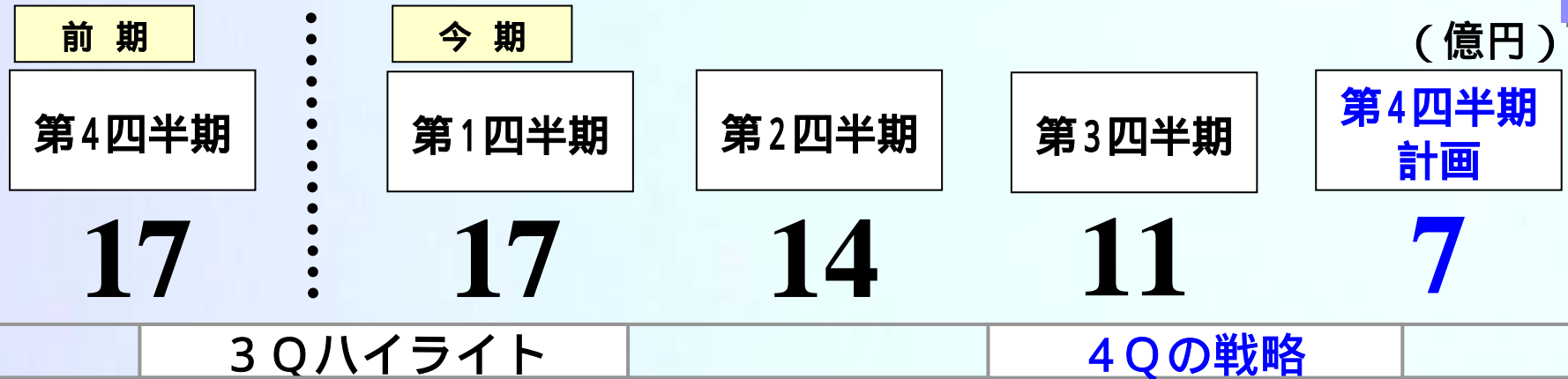
液晶関連事業の動向

➤ WPS-LGPについて



PSP比25%輝度アップ
標準仕様(サイズ)

オプト事業の動向



➤事業再構築の完了と持続的成長基盤の確立

- A I S レンズビジネスの戦略展開
 - ◆ 単品販売強化
 - ◆ 小型低背ビジネス強化
- ピックアップレンズ原価低減による市場対応
- 4 G 光通信の本格的普及による通信用レンズシェア拡大
- 攻めの営業体制
 - ◆ 新規受注獲得へ注力
 - ◆ 小型低背レンズの拡販
 - ◆ E(VN)での組立技術の確立
- 生産性の向上による市場対応



Challenge 45, New Enplas

by intelligence and vitality ~ 英智と活力 ~

ご清聴ありがとうございました。

株式会社エンプラス